

연수 제안서

연구 분야	반도체 소자/회로 집적화 및 패키징
연구 과제명	MEMS 소자 및 ASIC 회로 집적화 패키징 개발
연수 제안 업무	MEMS 소자 및 ASIC 회로를 집적화 및 패키징 공정
<p>(연수 내용)</p> <p>- 연수기간 : 2021.01.01. ~ 2022.12.31</p> <p>- 연수 내용 :</p> <ol style="list-style-type: none">1. MEMS 소자 및 ASIC 회로를 연결하기 위한 FPCB 설계 및 제작2. MEMS 소자 및 ASIC 회로를 집적화 하기 위한 Flip-chip 공정 개발3. 기계적, 열적, 전기적 안정성을 확보하기 위한 패키징 공정 개발	
소속 부 서 : 바이오마이크로시스템연구단	
연수 책임자 : 이 병 철	